

研究概要

研磨の基礎科学とイノベーション化の研究 —粗研磨から超精密研磨・CMPまで—

キーワード 研磨 / 基礎科学 / 最適化 / 固定砥粒 / 遊離砥粒

皆さんが日々使用されるスマートフォンやノートパソコン等々、その製造プロセスには必ず「研磨」があります。「研磨」されていない工業製品は無いと言っても過言では無いでしょう。「研磨」の歴史は非常に長く、古くは石器時代にも遡ります。しかし、いまだに未解明点が非常に多く、謎もたくさんあります。

本研究では研磨装置・研磨パッド・スラリー等の影響分析を行い、これらインターアクションを科学する手法開発と標準化、研磨の歴史・ノウハウ・技術伝承の在り方を探り、次代に向けた課題明確化と解決手法開発、さらなる高能率・高品位を具現し得るイノベーション化ツールの開発等、様々な取り組みを行っています。

今後の展開やメッセージ

研磨は、粗研磨から超精密研磨・CMPまで用途や要求に応じて幅広く使われています。是非、産学連携チームを構築し、基礎から応用(実用)に至るまでの実装化研究に挑戦することで研磨技術の体系化を一緒に図っていきましょう。是非、お気軽にお問い合わせください。

研究者情報



畷田 道雄 教授・博士(工学)

工学部 機械工学科

所属研究所：FMT研究所

金沢工業大学工学部機械工学科卒。同大学大学院博士課程(機械工学)修了。2000年防衛庁技術研究本部入庁、第3研究所所属、防衛庁技官。2002年本学助手就任、講師、助教授、2011年九州大学客員准教授(兼任、1年間)を経て、2013年現職。

研究者情報URL

<http://www.2.kanazawa-it.ac.jp/ishiune/kenma/kenma.htm>

